

Publication

EP 0142691 A2 19850529 (DE)

Application

EP 84112030 A 19841008

Priority

DE 3337856 A 19831018

Abstract (en)

[origin: US4568570A] A gentle and inexpensive process for activating surfaces for electroless metallization comprises wetting the surfaces with an activating solution containing a silver-I compound which is sparingly soluble in water (for example AgCl) and which has been converted into a soluble form with the aid of complexing agents (for example NH₃), splitting the soluble complex compound back into the sparingly soluble compound and reducing the silver-I compound remaining on the surface.

Abstract (de)

Ein schonendes und preiswertes Verfahren zur Aktivierung von Oberflächen für die stromlose Metallisierung besteht darin, daß man die Oberflächen mit einer Aktivierungslösung benetzt, die eine mit Hilfe von Komplexbildnern (z.B. NH₃) in eine lösliche Form überführte in Wasser schwer lösliche Silber-I-Verbindung (z.B. AgCl) enthält, die lösliche Komplexverbindung in die schwerlösliche Verbindung rückspaltet und die auf der Oberfläche zurückbleibende Silber-I-Verbindung reduziert.

IPC 1-7

C23C 18/28

IPC 8 full level

C23C 18/30 (2006.01); **C23C 18/28** (2006.01)

CPC (source: EP US)

C23C 18/28 (2013.01 - EP US)

Cited by

EP2559786B1

Designated contracting state (EPC)

BE CH DE FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0142691 A2 19850529; **EP 0142691 A3 19861029**; **EP 0142691 B1 19880921**; CA 1232498 A 19880209; DE 3337856 A1 19850425; DE 3474165 D1 19881027; JP S6096766 A 19850530; US 4568570 A 19860204

DOCDB simple family (application)

EP 84112030 A 19841008; CA 465497 A 19841016; DE 3337856 A 19831018; DE 3474165 T 19841008; JP 21446584 A 19841015; US 66100784 A 19841015